資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和８年10月30日

国立大学法人横浜国立大学長　梅原　出

◎調達機関番号 415　◎所在地番号　14

○第３号

１　調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量 300mm ウエハ対応ドライイン/ドライアウト CMP 装置 一式

(3) 調達方法　購入等

(4) 導入予定時期 令和 10 年１月

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

300mm ウエハに対応した研磨ユニットを２基以上備えるものであること。メタル及び非メタルの両研磨に対応し、スラリーの自動供給機構を具備すること。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限　令和８年11月30日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提供先　〒240-8501　横浜市保土ケ谷区常盤台79-1　国立大学法人横浜国立大学財務部経理課契約第一係 杉山 恵梨子 電話045-339-3241　E-Mail keiri.keiyaku1@ynu.ac.jp

３　説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間　令和８年10月30日から令和８年11月30日まで。

(2) 交付場所　上記2(2)に同じ。

４　その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

(1) Classification of the products to be procured : 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 300 mm Wafer Dry-in/Dry-out CMP system 1 Set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

The equipment shall be equipped with two or more polishing units compatible with 300mm wafers. It shall support both metal and non-metal polishing and shall be equipped with an automatic slurry supply system.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 30 November, 2026

(6) Contact point for the notice :SUGIYAMA Eriko, Accounting and Contract Division, Finance Department,National University Corporation Yokohama National University, 79-1 Tokiwadai Hodogaya-ku Yokohama-shi 240-8501 Japan, TEL 045-339-3241　E-Mail keiri.keiyaku1@ynu.ac.jp